

CESION

El (la) abajo firmante (En adelante EL CEDENTE)

- 1. LEE, Daekyu**
- 2. LEE, Jongwoon**
- 3. WON, Jongik**

en su carácter de inventor /diseñador con domicilio en:
1. 129 Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 16677, Corea
2. 129 Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 16677, Corea
3. 129 Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 16677, Corea

por el presente documento declara que cede todos y cada uno de los derechos que le corresponden o puedan corresponderle sobre la siguiente invención, modelo de utilidad, diseño industrial **No. PCT/KR2024/006399**

a: **SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.**

con domicilio en 129 Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 16677, Corea.

En prueba de la mutua aceptación de esta cesión ambas partes CEDENTE y CESIONARIO firman el presente documento.

Dado y firmado en

A los Días de de

- 1. LEE, Daekyu**

El Cedente

- 2. LEE, Jongwoon**

El Cedente

- 3. WON, Jongik**

El Cedente

ASSIGNMENT

The undersigned (Hereinafter THE ASSIGNOR)

- 1. LEE, Daekyu**
- 2. LEE, Jongwoon**
- 3. WON, Jongik**

Inventor /designor of domiciled at
1. 129 Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 16677, Korea.
2. 129 Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 16677, Korea.
3. 129 Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 16677, Korea.

Do hereby declares that it assigns all and each of his rights and privileges on the following invention, industrial design, utility model **No. PCT/KR2024/006399**

To: **SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.**

with domicile in 129 Samsung-ro Yeongtong-gu, Suwon-si Gyeonggi-do 16677, Korea.

As a proof of the mutual acceptance of this assignment, both parties ASSIGNOR and ASSIGNEE sign the present document.

Granted and signed at

on this 24 day of November, 2025 of

- 1. LEE, Daekyu**

The Assignor

- 2. LEE, Jongwoon**

The Assignor

- 3. WON, Jongik**

The Assignor